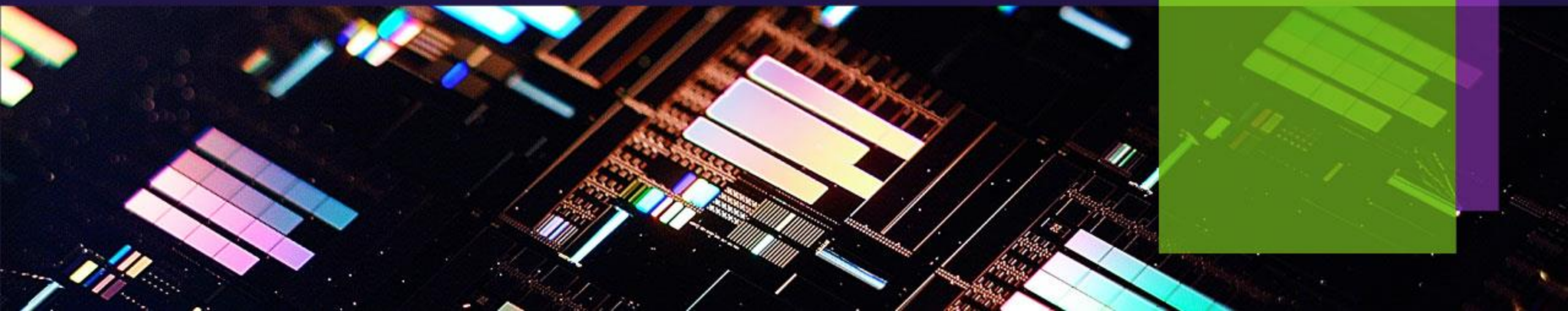


2023年3月期 第3四半期（2022年10月～12月） 東京エレクトロン 決算説明会

2023年2月9日

内容：

- 連結決算の概要 執行役員 ファイナンスユニットGM 川本 弘
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、地政学的リスク、半導体/FPD*市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルス感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

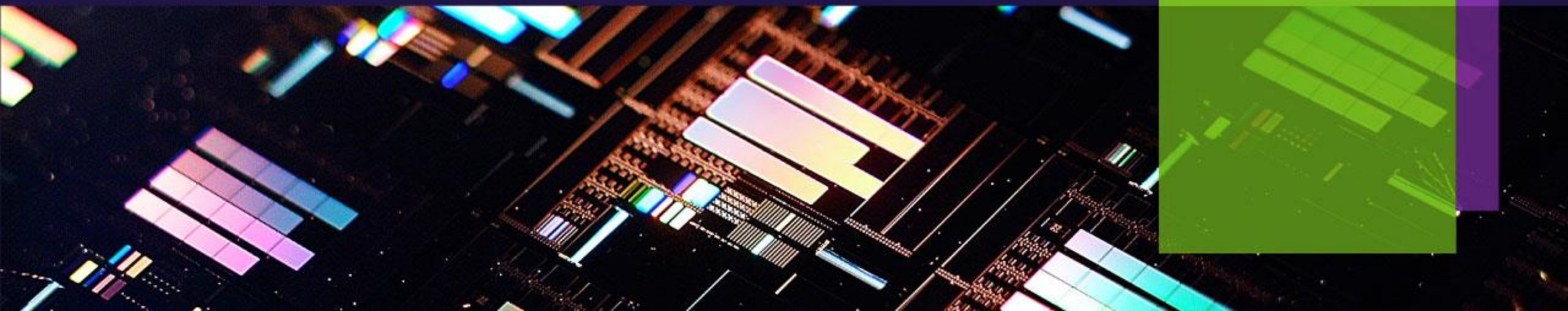
当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は極めて軽微です。

* FPD : フラットパネルディスプレイ

第3四半期 連結決算の概要

2023年2月9日

川本 弘
執行役員 ファイナンスユニットGM



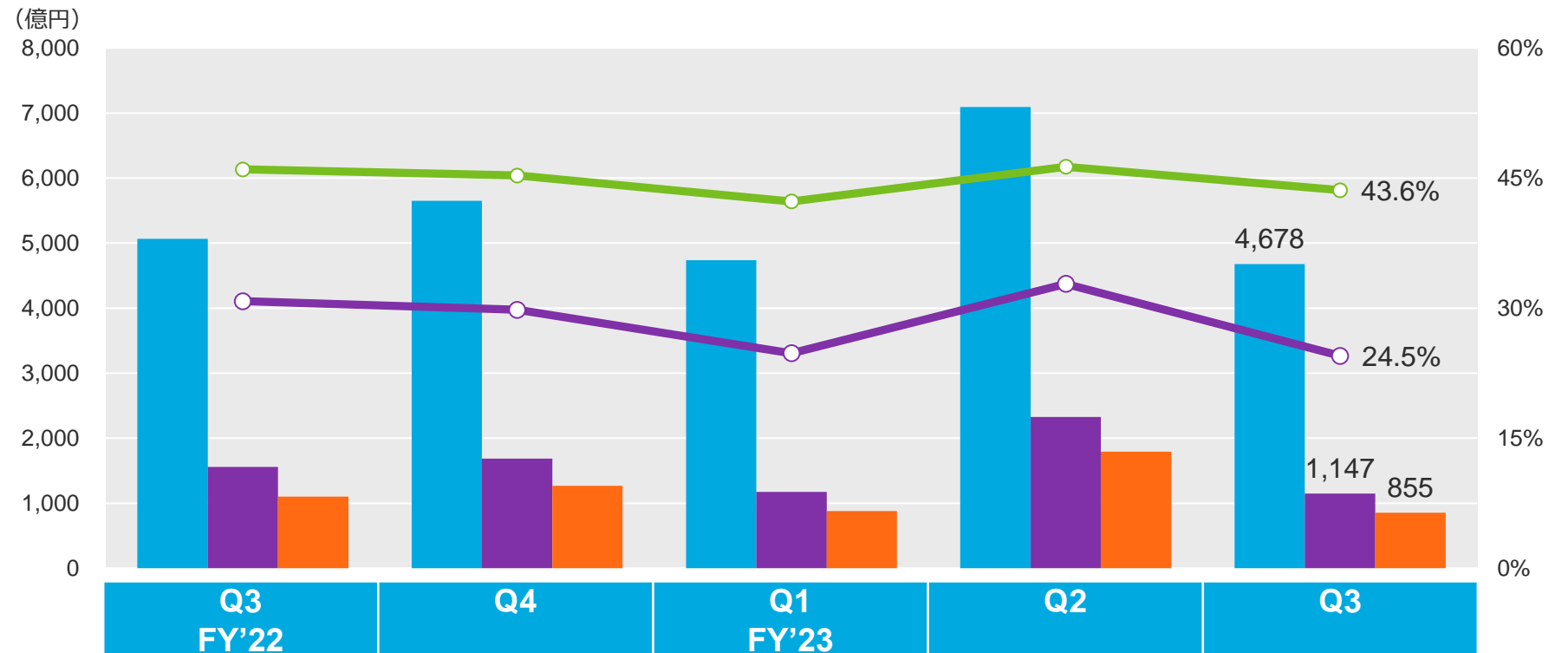
損益状況

(億円)

	FY2022		FY2023			対FY2023 Q2 増減
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
売上高	5,064	5,648	4,736	7,092	4,678	-34.0%
SPE	4,888	5,492	4,640	6,890	4,588	-33.4%
FPD	176	155	96	201	89	-55.4%
売上総利益	2,330	2,559	2,005	3,282	2,039	-37.9%
下段：売上総利益率	46.0%	45.3%	42.3%	46.3%	43.6%	-2.7pts
販管費	769	873	830	956	891	-6.8%
営業利益	1,560	1,685	1,175	2,326	1,147	-50.7%
下段：営業利益率	30.8%	29.8%	24.8%	32.8%	24.5%	-8.3pts
税金等調整前当期純利益	1,555	1,681	1,176	2,352	1,163	-50.6%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,100	1,268	880	1,792	855	-52.3%
研究開発費	385	441	421	491	461	-6.3%
設備投資額	174	147	180	173	125	-27.6%
減価償却費	96	102	97	98	112	+13.8%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

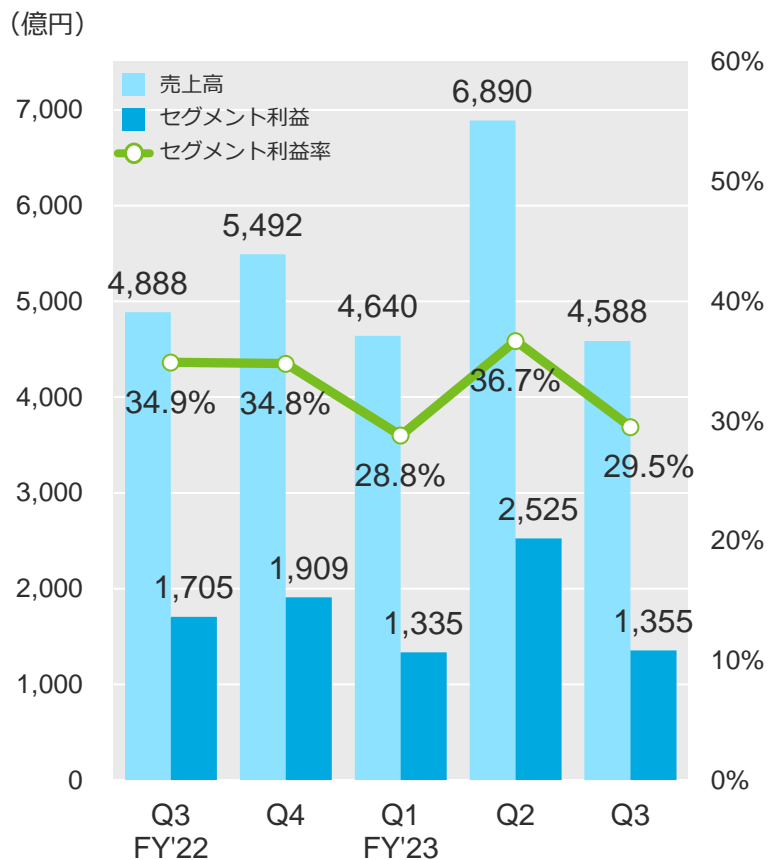
損益状況



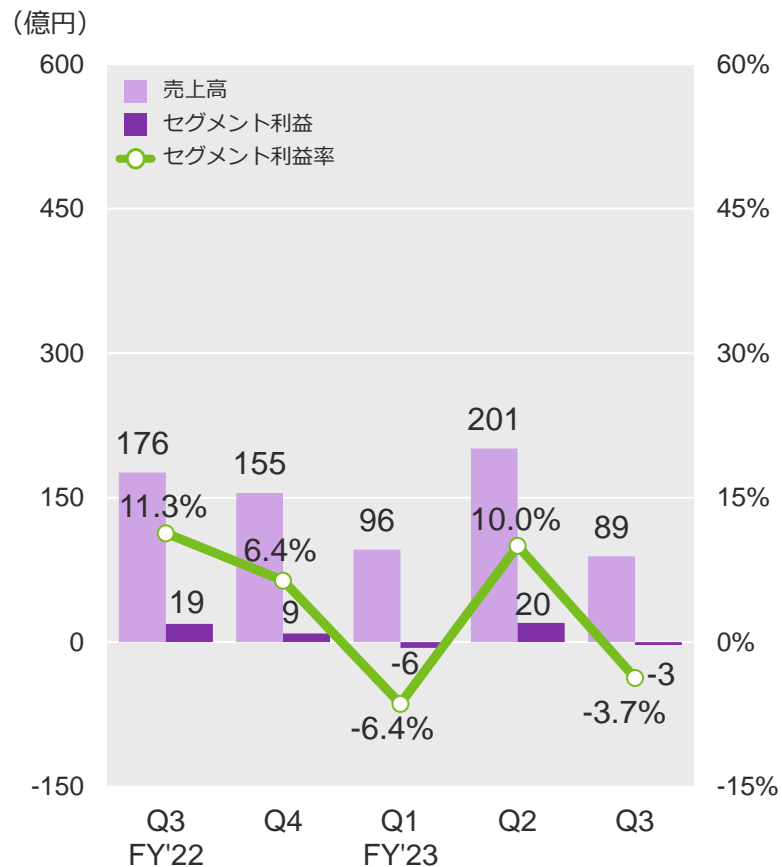
■ 売上高	5,064	5,648	4,736	7,092	4,678
■ 営業利益	1,560	1,685	1,175	2,326	1,147
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	1,100	1,268	880	1,792	855
○ 売上総利益率	46.0%	45.3%	42.3%	46.3%	43.6%
○ 営業利益率	30.8%	29.8%	24.8%	32.8%	24.5%

セグメント情報

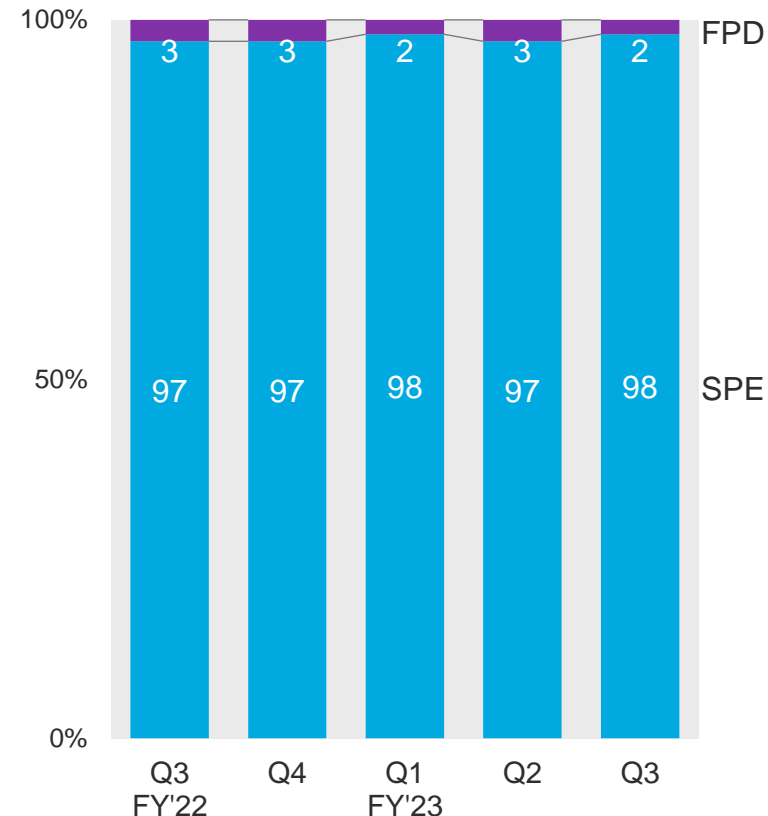
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)

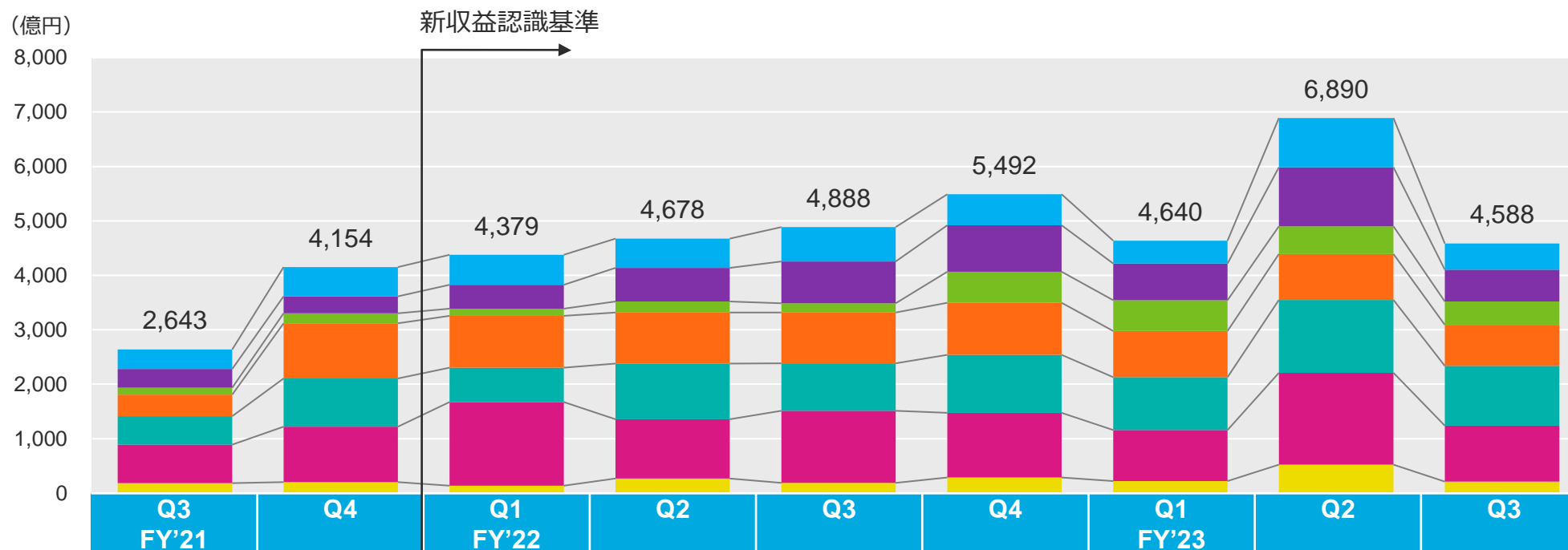


売上構成比率



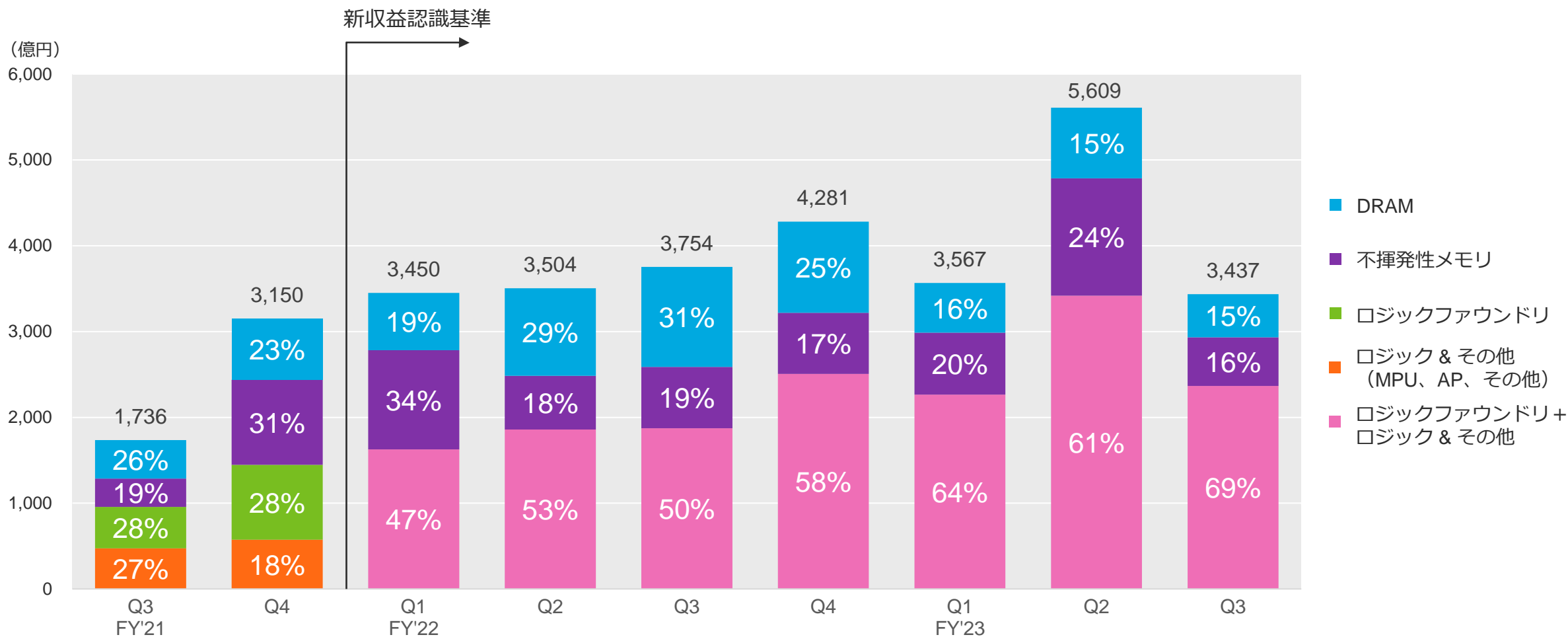
1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

SPE部門 地域別売上高

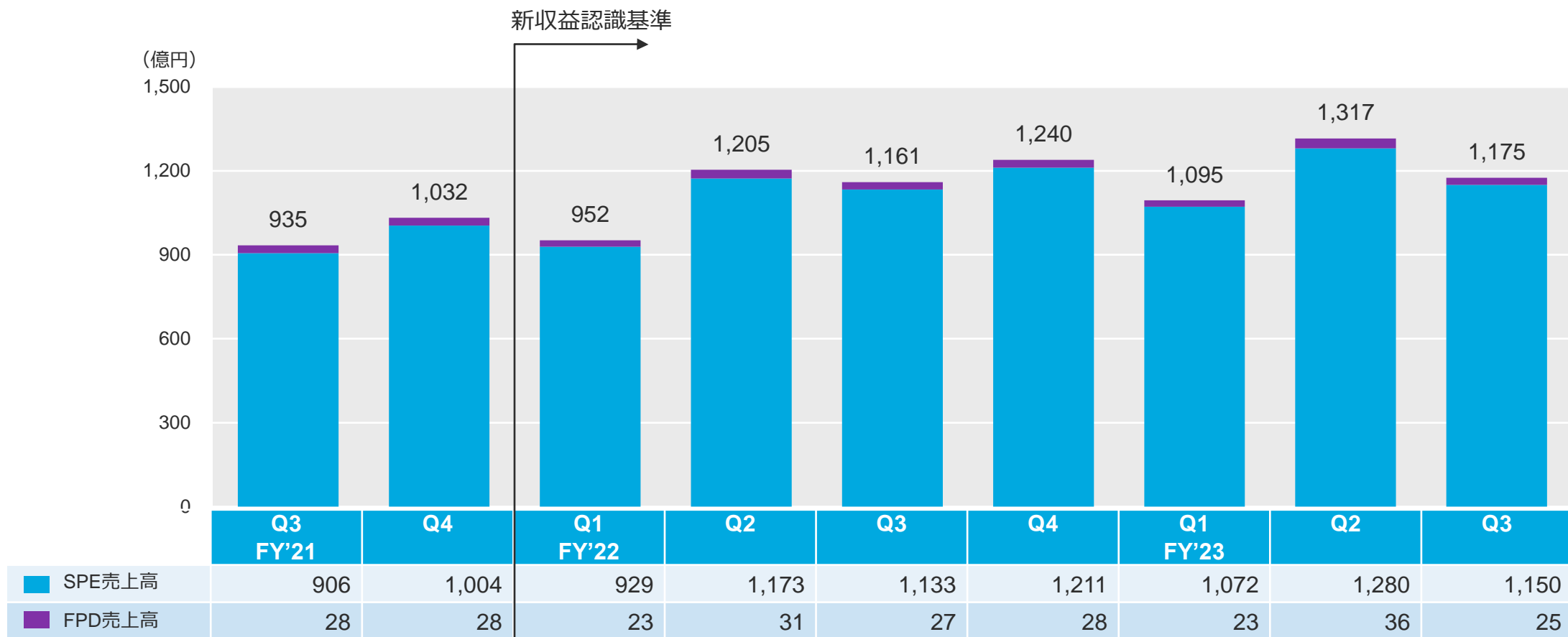


■ 日本	361	536	548	539	631	569	420	905	482
■ 北米	345	312	439	618	768	853	673	1,083	584
■ 欧州	127	186	134	203	170	571	565	509	426
■ 韓国	393	1,014	953	935	930	959	851	842	754
■ 台湾	525	882	628	1,025	874	1,063	968	1,338	1,101
■ 中国	705	1,022	1,536	1,088	1,322	1,188	940	1,686	1,027
■ 東南アジア・他	184	200	138	267	189	287	220	525	211

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



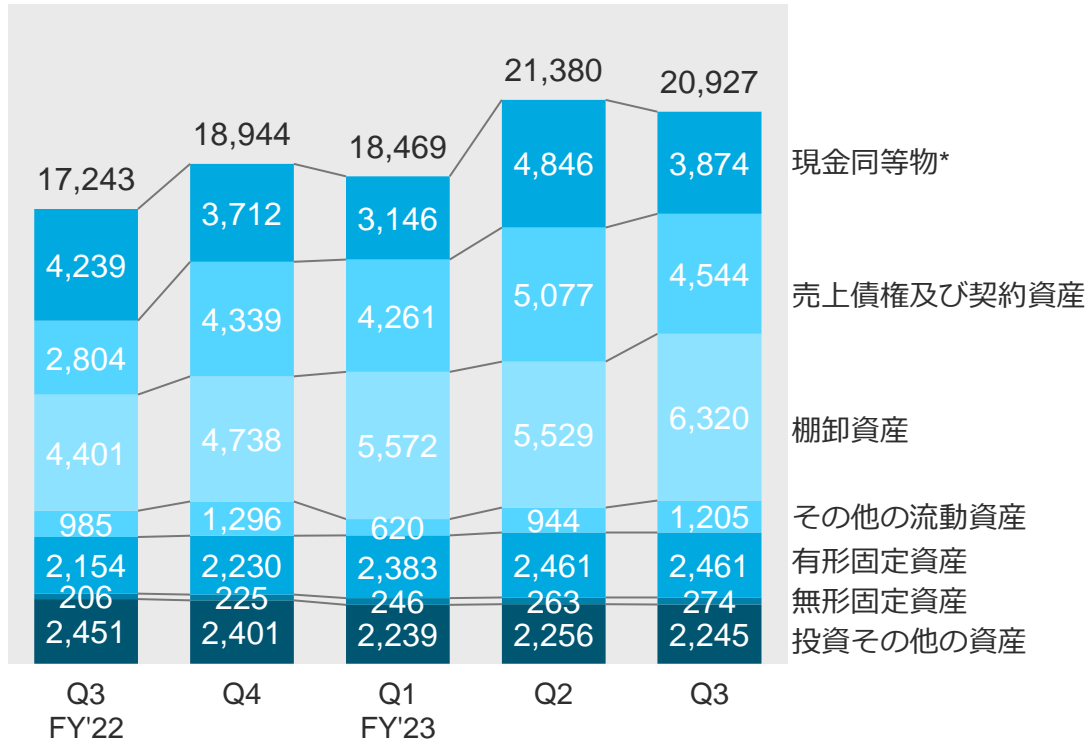
フィールドソリューション売上高



貸借対照表

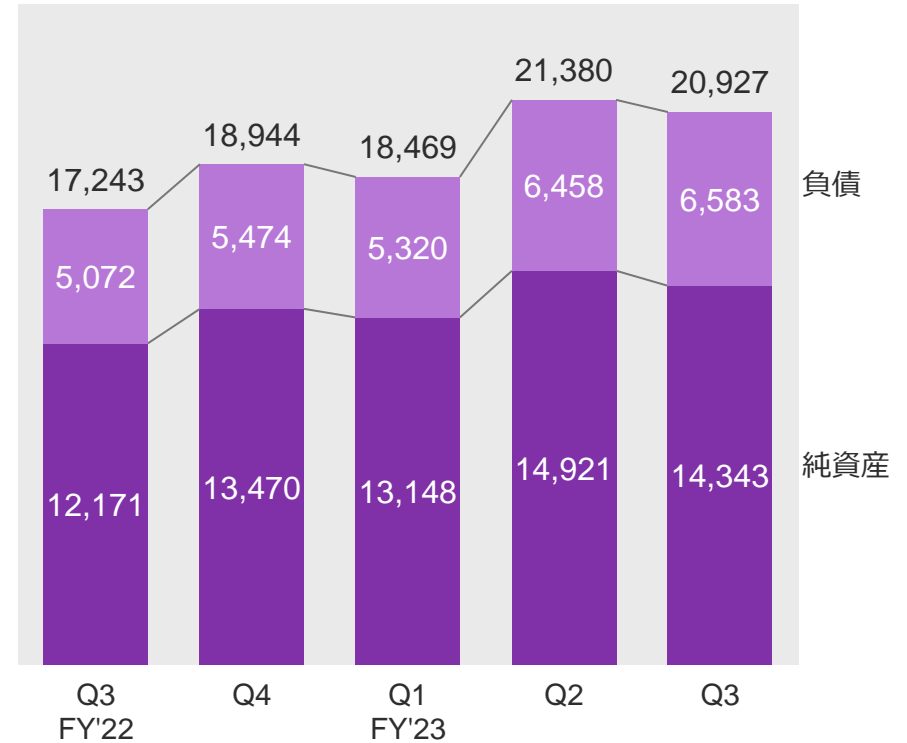
資産

(億円)



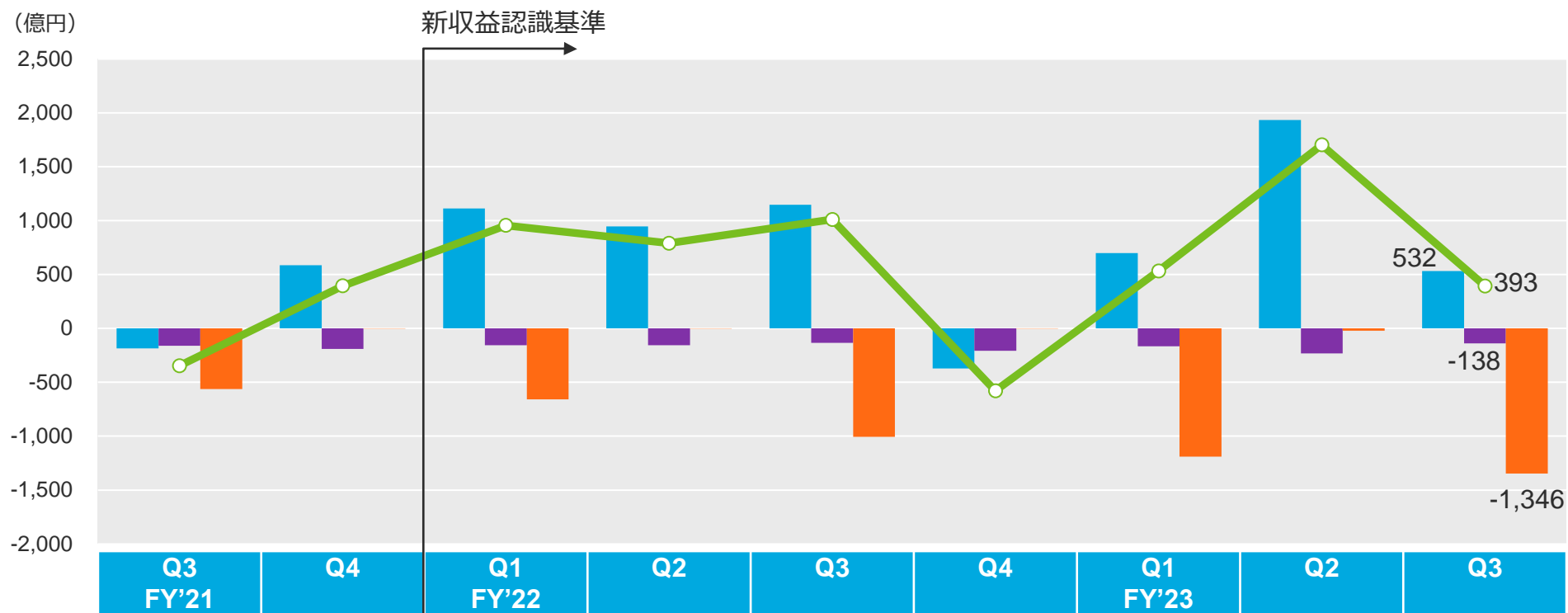
負債・純資産

(億円)



* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー



	Q3 FY'21	Q4 FY'21	Q1 FY'22	Q2 FY'22	Q3 FY'22	Q4 FY'22	Q1 FY'23	Q2 FY'23	Q3 FY'23
営業キャッシュ・フロー	-186	586	1,112	946	1,146	-371	699	1,934	532
投資キャッシュ・フロー*1	-160	-191	-157	-155	-135	-207	-166	-231	-138
財務キャッシュ・フロー	-564	-1	-659	-2	-1,007	-2	-1,191	-21	-1,346
フリーキャッシュ・フロー*2	-347	394	955	790	1,010	-579	533	1,702	393
手元資金残高*3	2,690	3,115	3,417	4,204	4,239	3,712	3,146	4,846	3,874

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー (定期預金および短期投資の増減を除く)

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3か月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

株式分割のお知らせ

目的	投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図る
分割の方法	2023年3月31日を基準日として、同日付の株主の所有する当社普通株式を1株につき3株の割合をもって分割
日程	基準日公告日 : 2023年3月16日 基準日 : 2023年3月31日 効力発生日 : 2023年4月1日
配当	2023年3月31日を基準日とする2023年3月期の期末配当は、株式分割前の株式数を基準に実施

事業環境および業績予想

2023年2月9日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



事業環境（2023年2月時点での見方）

- デジタル化の進展によりWFE*1市場は一段上の成長フェーズに
 - CY2020に\$65Bだった市場規模は、CY2021は\$92B、CY2022は約\$100Bで着地したと予測
- WFE市場は目下調整局面だが、CY2023後半から徐々に回復し、通年では約\$80Bになる見込み
- CY2024以降も半導体およびWFE市場は力強く伸長し、さらなる成長段階へ
 - 新CPUやエネルギー効率の良い半導体の採用による、データセンターの刷新、CY2025には本格的なサービス開始が期待されるメタバース、電気自動車の普及、スマートフォン需要の回復などが牽引役
 - 各国政府による半導体設備投資サポートや、DX*2・GX*3政策の再加速も追い風に

*1 WFE：半導体前工程製造装置（WFE；Wafer fab equipment）。半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 DX：Digital transformation

*3 GX：Green transformation

FY2023 Q3 事業進捗

■ SPE事業は計画通り進捗

- CY2022は売上高 2兆1,611億円、新規装置売上は前年比 22%増加。
WFE市場の成長率 (+8%) をアウトパフォーム
 - 調達不安が続く中、強固なサプライチェーンで対応
- 戦略製品によるPOR*獲得や、将来成長に向けた開発装置選定も順調に進捗

■ 枚葉洗浄装置 CELLESTA™ MS2をリリース。 両面同時処理により高生産性を実現

■ さらなる事業機会の拡大にむけて組織再編を決定



CELLESTA™ MS2

* POR (Process of record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

M

A

G

I

C

Metaverse

Autonomous
Mobility

Green
Energy

IoT &
Information

Communications

Power Device
(Si/SiC/GaN)

Waveguide

μ LED

Si
Photonics

CIS

Displays

RF

さらなる事業機会拡大に向けた組織再編



Metaverse Autonomous mobility Green energy IoT & information Communication



DSS BU

Diverse Systems and Solutions

- 成長エリアに資源集中
- FS* BUとFPD BUを統合
- MAGIC市場への対応力強化

* FS : フィールドソリューション

FPD事業について

- FPD TFTアレイ工程*向け製造装置市場は、大型投資案件が一服。CY2023は前年比30～40%の減少を見込む
- セグメントを集約し、選択と集中を推進
 - FS BUとFPD BUを統合し、DSS（Diverse Systems and Solutions）BUに再編。企業価値向上を目指し、新たなターゲット市場「MAGIC」を設定
 - インクジェット描画装置の開発プロジェクトを中止
 - 成長分野である「MAGIC」向け製造装置にリソースを再配置
 - FPD製造装置については、エッチングなど高付加価値エリアに特化
- FY2024から半導体製造装置の単一セグメントで開示する

* TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能をもつ基板を製造する工程

FY2023 業績予想

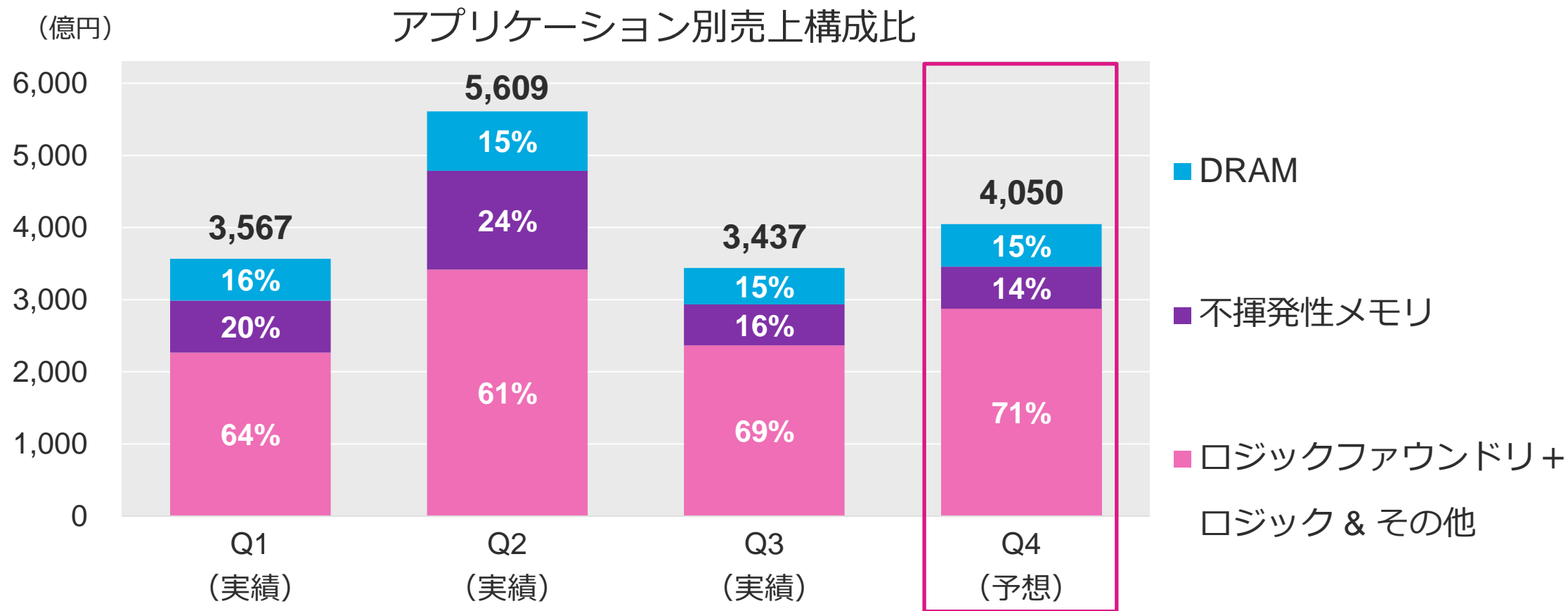
FY2023 業績予想

(億円)

	FY2022		FY2023			
	実績 通期	実績 H1	新予想		修正額* 通期	
			H2	通期		
売上高	20,038	11,828	9,872	21,700	+700	
SPE	19,438	11,530	9,650	21,180	+720	
FPD	598	297	223	520	-20	
売上総利益 下段：売上総利益率	9,118 45.5%	5,288 44.7%	4,172 42.3%	9,460 43.6%	+360 +0.3pts	
販管費	3,125	1,786	1,874	3,660	+20	
営業利益 下段：営業利益率	5,992 29.9%	3,501 29.6%	2,299 23.3%	5,800 26.7%	+340 +0.7pts	
税金等調整前当期純利益	5,966	3,529	2,311	5,840	+350	
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,370	2,673	1,657	4,330	+330	
1株当たり当期純利益 (円)	2,807.84	1,715.27	-	2,776.15	+211.22	

Q3実績およびQ4見通しを反映し、業績予想を修正

FY2023 Q4 SPE部門 新規装置売上予想

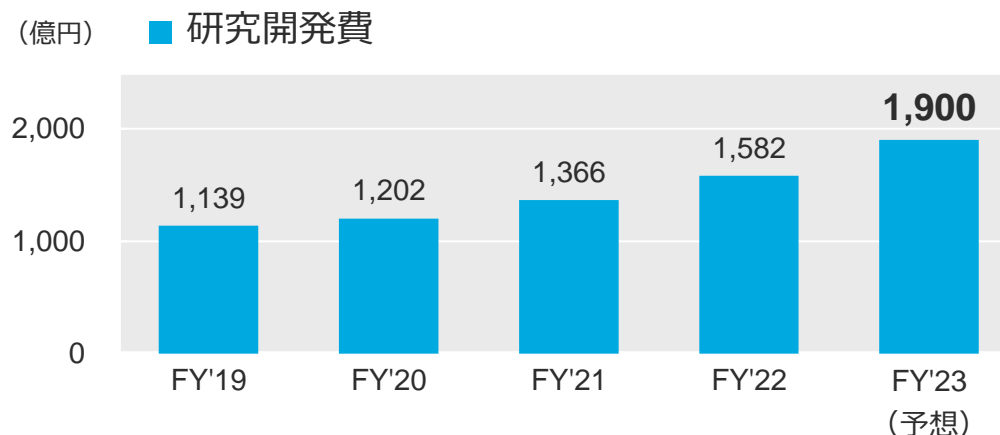


CYベースでは22%の成長を達成。

FYベースでも前期実績（過去最高）に対し11%の成長を見込む

FY2023 研究開発費・設備投資計画

- 研究開発費 1,900億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資
- 設備投資 750億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 460億円



新開発棟
(コート/デベロッパ、サーフェスプレパレーション)

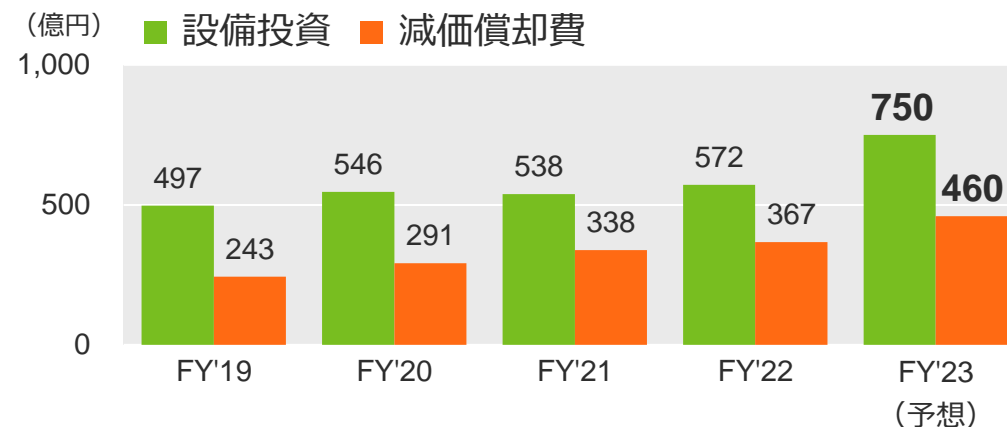


熊本県合志市：建設費約300億円
(2024年秋 竣工予定)

新開発棟
(エッチング)



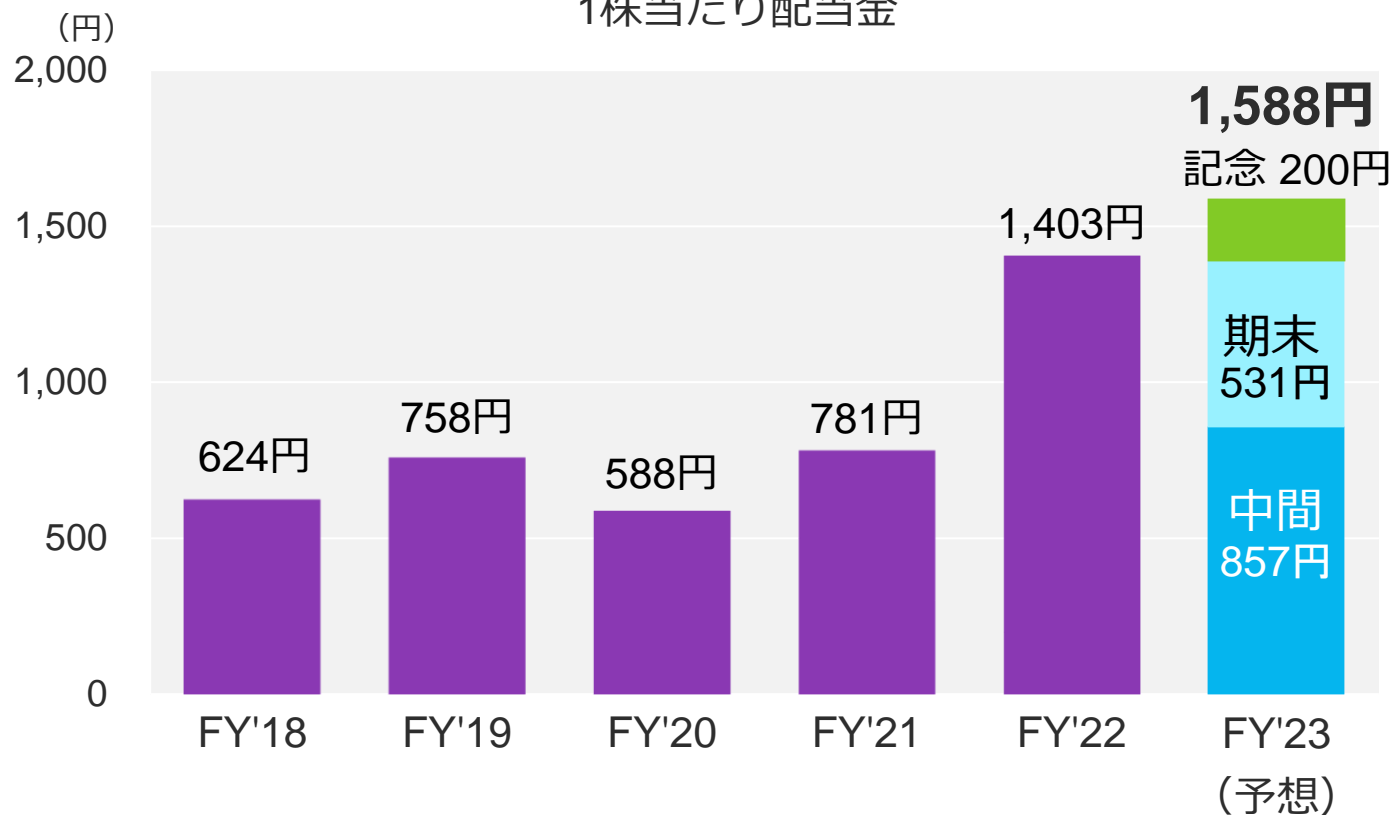
宮城県大和町：建設費約470億円
(2025年春 竣工予定)



今後5年で、研究開発費は1兆円超、設備投資は4,000億円超を想定。
さらなる成長に向け生産効率の向上を図る

FY2023 配当予想

1株当たり配当金



当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

60周年記念配当 200円を加え、通期配当金は 1,588円を予定

TEL™

TOKYO ELECTRON